

烟台德邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技

证券代码：688035

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称	东北证券、财通证券、东方证券、海通证券、开源证券、中信证券、华夏基金、中金公司、申万菱信、招商基金、长江养老、银华基金、宝盈基金、博时基金、易方达基金、华安财保资管、德邦基金、国泰基金、华夏久盈资管、富国基金、建信基金、交银施罗德、平安养老保险、新华基金、中银国际、国金证券、中邮证券等 90 余家机构
时间	2024 年 12 月 29 日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	德邦科技董事、总经理：陈田安 德邦科技副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰 苏州泰吉诺董事长、总经理：李兆强 苏州泰吉诺副总经理：于海蔚 德邦科技董事会办公室总监：战世能
投资者关系活动主要内容介绍	1、关于公司本次收购泰吉诺的基本情况介绍？ 答：公司于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-077），公司将以现金方式收购苏州泰吉诺 89.42%的股权，旨在深化公司在半导体封装材料领域的布局。公司通过收并购等资本运作实现快速发展，有助于公司获取更多资源和

技术, 实现业务多元化发展。

公司始终致力于成为全球高端封装材料引领者, 在先进封装材料上持续加大投入。产品包括晶圆处理材料、固晶材料、半导体倒装芯片封装材料等 AI 芯片、高端芯片的高算力芯片封装材料。导热材料在先进封装中占据重要地位, 本次收购是公司在先进封装材料领域加快战略步伐的重要举措。

2、泰吉诺的基本情况介绍?

泰吉诺成立于 2018 年, 位于江苏省苏州常熟市, 是国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、江苏省民营科技企业。目前共有 90 余人, 其中研发人员 20 余人, 包含博士 2 人、硕士 8 人, 公司核心研发、市场以及运营团队多来自全球知名电子材料外资企业, 如莱尔德、固美丽、霍尼韦尔、诺莱特等, 均具有十年以上行业经验。截至目前公司累计获得授权专利四十余项, 包括十余项发明专利。

泰吉诺主营高端导热界面材料, 应用于半导体集成电路封装, 提供从 TIM 1、TIM1.5 到 TIM 2 的全套解决方案, 其中芯片级产品包括 TIM 1 和 TIM 1.5, 主要应用于 AI 服务器、CPU、GPU 主控芯片及智能消费电子领域, 以及针对 AI 服务器的浸没式液冷服务器开发用于主控芯片与散热器之间的液态金属片产品。TIM2 产品包括导热垫片、凝胶垫片以及导热单/双组份凝胶等。应用于 AI 服务器、5G 通讯基站、消费电子、新能源汽车智能域控芯片等领域。

泰吉诺现有工厂面积 5000 余平方米, 满产产能包含约 5000 吨导热胶、100 万平方米导热片、10 万支导热胶。

3、泰吉诺经营情况及数据?

答: 泰吉诺 2024 年前三季度营收约 4100 万元, 同比增长 80%以上。2024 年前三季度净利润超过 1100 万元。毛利率接近

60%，净利润率超过 20%。营收和利润的快速增长主要得益于 AI 客户产品验证成功和增量订单。未来的增长除了新客户开拓和产品渗透率提升外，主要还是要关注整个 AI 行业的发展速度和国产算力产业链的发展趋势。

4、泰吉诺收入构成、应用场景？对外销售产品类型？

答：1、数据中心服务器：以 AI 为代表的数据中心服务器，约占 40%。主要产品：高导热垫片和高导热凝胶垫片。

2、通讯基站：通信基站 AAU、RRU 芯片使用的导热界面材料，约占 30%。产品类型：中等导热系数的特殊设计导热垫片、相变化材料（PCM），用于 AAU 和大功率芯片。

3、汽车电子：电机、电控、智能化域控芯片、激光雷达等使用的导热界面材料，。约占 20%。主要产品：单组份导热凝胶、双组份导热凝胶。

4、高功率工业设备和医疗设备：约占 10%。

5、德邦有一个深圳子公司，从事类似的热界面材料的业务，两家公司产品的互补性展望？

答：德邦科技深圳子公司主要侧重存储芯片、网络基站辅助芯片、智能终端芯片、智能穿戴设备、新能源汽车散热需求。苏州泰吉诺主要专注于 AI 芯片、高算力芯片、GPU 主芯片、网络设备主芯片散热、汽车电子域控芯片散热，以及液态金属和锡箔材料等特色产品线。

苏州泰吉诺在高导热、低热阻、超薄技术含量上有独特技术，技术区别导致产品和市场应用场景互补。双方各自拥有不同客户和市场，市场重叠几率小，互补性强。

苏州泰吉诺在产品开发上投入大，市场导入和国际化产业基地方面有待加强。德邦科技在全国乃至全球的销售网络布局，

以及国际化产业基地布局，能为苏州泰吉诺提供协同效应。收购苏州泰吉诺对德邦科技具有战略意义，增强了德邦在半导体芯片热界面产品的市场定位和份额，扩展了德邦在半导体先进封装材料上的产品线长度、解决方案能力和市场增长潜力。

6、泰吉诺后续增长驱动力，新客户情况？

答：泰吉诺对自身发展有信心，做出了业绩承诺。预计年复合增长率达到 30%。

增长点：主要围绕 AI 领域，包括 AI 数据中心、服务器、终端消费电子、通讯及边缘设备。

随着人工智能的普及，热管理问题日益突出，泰吉诺抓住了这一机会点。

客户开拓：计划借助并购契机，开拓国内外重要客户。通过定制化开发能力，结合德邦科技的客户资源积累，实现业绩快速增长。

德邦科技的协同效应：德邦科技在芯片、半导体和先进封装领域有多年客户拓展和积累。泰吉诺与德邦科技的互补合作将带来更快速的业绩增长。

7、泰吉诺对标 A 股里有合适的可比公司吗？

答：根据 Prisma 研报分析表明，全球 80% 的市场份额被全球排名前十的外资企业垄断，如汉高、固美丽、莱尔德、道康宁、日本富士、信越化学、霍尼韦尔等，中国导热界面材料生产厂家数量较多，但市占率不足 10%。国内技术起步较晚，对客户痛点分析和认知亟待提升，在 AI、5G 通讯基站、新能源域控系统中高端需求领域的渗透非常低。泰吉诺产品定位上述行业散热痛点问题，开发高端定制化导热材料解决方案，与国内上市公司产品在综合性能定制化和客户痛点解决方案方面

有所区别，因为不同公司针对的领域有所不同，因此没有合适的可比性。

8、泰吉诺浸没式液冷导入客户进度？后续研发方向和研发难点？

答：针对浸没式液冷，泰吉诺目前大力发展钢基液态金属片，解决传统高分子界面材料在氟化液或合成油里面长期浸没带来的溶胀溶解问题的同时满足解热的需求，目前产品方案陆续已经在客户端测试通过，进入试产阶段。

针对浸没式液冷研发方向问题，公司主要围绕钢基液态金属片的表面处理做深入研究，重点突破降低钢片与芯片及散热表现接触热阻。

9、针对下一代 AI 服务器，泰吉诺有何产品布局，客户验证情况如何？

答：针对下一代 AI 服务器，泰吉诺开发了业内已知的绝缘型、高导热、低应力、低渗油 14W/mK 导热垫片，该产品主要用于显存芯片与冷板散热器之间。。目前国内外 GPU 芯片设计和模组客户正在验证该产品，部分客户验证测试已通过，等待量产，在下一代 GPU 模组中有望大量应用。冷板式服务器散热是 AI 服务器目前主要的散热模式，因此高导热系数的导热界面材料非常重要。

对于 GPU 模组热设计功率超过 1000 瓦需求，更高导热系数的产品将会有更大的市场，泰吉诺正在开发 15 瓦到 20 瓦的绝缘型高导热、低应力、低渗油导热界面材料。可能的技术方向包括使用氮化硼取向材料、金刚石填充以及氮化铝复配等新型材料。

10、德邦后续战略布局？有无其他并购计划？

答：并购是企业快速发展的有效手段，对企业做大做强和实现高质量发展具有重要意义，今年以来国家各个层面积极支持企业并购，与泰吉诺的合作是积极的一步，积累了成功经验和良好的尝试。双方产品互补性分析和布局正在进行中。在国内市场拥有良好基础，并计划进一步开发。利用泰吉诺已有的国际市场基础进行产品拓展。计划在国内和国外布局生产基地，以应对各种挑战。公司将继续围绕主业挖掘优质标的，暂时还没有达到披露条件或进入审批程序的项目信息可以分享。

11、德邦固晶胶膜（DAF 膜）明年发展预期？

答：德邦科技的产品线覆盖晶圆制成后的减薄、划片、固晶等全系列流程。固晶胶膜（DAF 膜）是 2.5D/3D 封装中的重要趋势性产品，包括普通导热导电的 DAF 和高导热导电的 CDAF，国内企业能商业批量供货的很少。公司 DAF/CDAF 膜已具备完全替代国外竞品的能力，目前已通过国内知名封测企业、主要设计公司以及关键芯片设计或应用公司等数十家企业认证，并已有十余家企业开始小批量供货，预计明年批量供货的客户还会增加，但具体销量不太好预测，需结合客户需求。

12、AI 服务器未来会不会用相变化材料(PCM)，泰吉诺 PCM 的优势是什么？

答：随着 AI 服务器中 GPU、ASIC 芯片和 TPU 等主流芯片的功率增大，主流导热解决方案有从传统导热材料转向相变化材料转变的趋势。得益于客户资源和市场品牌效应，泰吉诺正逐渐切入相变化材料市场，已有客户在测试和下订单，目前已获得一些低端 AI 项目订单，预计未来会快速成长。后续，借助德邦科技更大的平台和品牌背书，将成为重要的成长点。

相变材料（PCM）的优点：PCM 是未来重要的导热材料选项之一，PCM 具备低热阻、高可靠性、自修复性、可达到较高的热导率等特点，随着功率和密度提升，对导热材料的要求越来越高，PCM 的性能将得到更好的发挥。

13、德邦科技各板块 2024 年和 2025 年展望？

答：从 2024 年前三季度来看，公司各业务板块实现了不同程度的增长，其中集成电路和智能终端板块均实现了较大幅度的增长。集成电路板块得益于 DAF/CDAF、underfill、AD 胶等新产品的验证突破，UV 膜、固晶胶、导热材料等原有产品份额持续提升，板块增长幅度明显好于行业增速，智能终端板块得益于苹果客户 TWS 耳机需求的快速恢复，pad、vision pro 等新的应用点的导入、上量，国内安卓系客户的多点放量，车载端的突破和起量，多点开花的局面带来了智能终端板块的大幅增长。新能源板块在下游客户降价的情况下，仍实现小幅增长，同时公司通过自动化产线、原材料采购降本、技术降本等有效措施，实现了新能源板块毛利率持续稳步回升。第四季度延续了前三季度良好的增长态势。

2025 年各板块将继续以客户需求为导向，继续加强研发投入，推动新产品的持续突破、上量，继续优化产品结构，持续增强公司综合盈利能力。目前我们对 2025 年业务持较为乐观的展望。

14、收购泰吉诺后，公司业务结构将会有何变化？

答：泰吉诺业务覆盖集成电路封装，专注于芯片散热材料。并表后，公司各板块业务占比将得到一定的优化，其中集成电路封装材料业务占比有望达到 20%左右，板块毛利率也将有所提升。其他板块业务占比将会有所下降。另外，随着业务协同

	的深入，将提高公司热界面材料整体增长预期，我们将努力实现 1+1>2 战略整合效果。
附件清单（如有）	无